NEWS RELEASE

2026 年 11 月 24 日
キヤノン株式会社
キヤノンアネルバ株式会社
キヤノンマシナリー株式会社

キヤノンが「SEMICON Japan 2026」に出展
半導体製造の多様化に貢献する装置や技術を紹介

キヤノン株式会社、キヤノンアネルバ株式会社、キヤノンマシナリー株式会社の 3 社は、2026 年 12 月 9 日（水）から 11 日（金）まで、東京ビッグサイトで開催される半導体産業の国際展示会「SEMICON Japan 2026」に出展します。



キヤノンブース（イメージ）

近年、半導体製造においては、装置の安定稼働はもちろんのこと、半導体の高性能化に伴い、微細化技術や先端パッケージング技術のニーズが高まっています。また、デバイスごとに求められる性能や用途が多様化する中、さまざまな基板仕様や製造要件への対応が求められています。キヤノンブースでは、先端半導体製造現場での活用が期待される最新のウエハー平坦化技術から、半導体製造プロセスの多様化に対応する後工程向けの装置まで、幅広い半導体製造に貢献する技術や製品を紹介します。

■ 世界初のウエハー平坦化技術や ArF ドライ半導体露光装置などキヤノンの最新技術・製品

ナノインプリントリソグラフィ技術を用いた世界初※1 のウエハー平坦化技術「Inkjet-based Adaptive Planarization」を紹介します。また、キヤノンとして約 24 年ぶり※2 の市場投入となる ArF※3 ドライ半導体露光装置「FPA-6300AS6」※4（2026 年 12 月上旬受注開始予定）や、KrF※5 半導体露光装置「FPA-6400ES6a」※4（2026 年 12 月上旬発売予定）などの新製品をパネルで展示します。そのほか、先端パッケージングに対応する後工程向け露光装置など、キヤノンの幅広い技術・製品を紹介します。

■ 幅広い半導体製造に貢献するキヤノングループの製品群

多様化する半導体製造のニーズに応じ、さまざまなプロセスモジュールを柔軟に組み合わせられる装置シリーズ「Adastra」※6（2024 年 10 月発売）のモックアップを展示し、半導体の進化を支える多様なプロセス技術を紹介します。また、「BESTEM-D610」※7（2025 年 1 月発売）をはじめとするダイボンダー装置、先端パッケージング向けコイニング装置など、半導体デバイスやパッケージ基板製造に欠かせないキヤノングループの幅広い製品ラインアップを紹介します。

※1　ナノインプリントリソグラフィ技術を応用したウエハー平坦化技術の実用化において。（2026 年 1 月 12 日時点・キヤノン調べ）
※2　「FPA-6000AS4」（2002 年 7 月受注開始）以来、約 24 年ぶり。
※3　フッ化アルゴン。露光波長は 193nm。
※4　キヤノン株式会社製。
※5　フッ化クリプトン。露光波長は 248nm。
※6　キヤノンアネルバ株式会社製。
※7　キヤノンマシナリー株式会社製。

● 産業機器ホームページ　　：https://global.canon/ja/business/industrial.html

〈SEMICON Japan 2026 開催概要〉

会　　期：2026 年 12 月 9 日（水）～11 日（金）10：00～17：00
会　　場：東京ビッグサイト
入　場　料：無料（要事前登録）https://www.semiconjapan.org/jp/about/pricing-and-register
キヤノンブース：東展示棟 1 階

〈キヤノングループの半導体製造装置について〉

